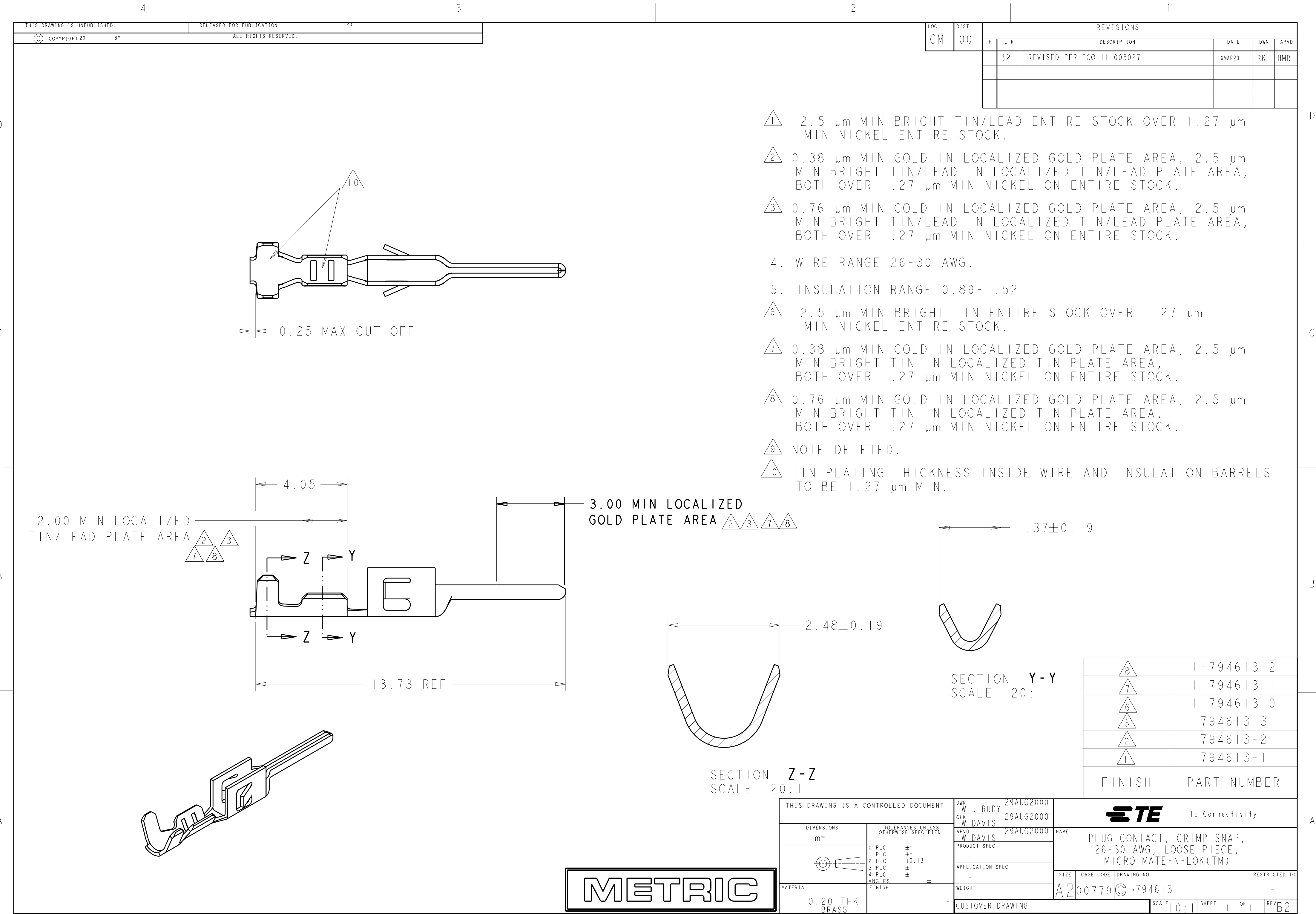




THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION		20	
© COPYRIGHT 20		BY -		ALL RIGHTS RESERVED.	

LOC	DIST	REVISIONS			
CM	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE
					DWN
					APVD
		B2		REVISED PER ECO-11-005027	16MAR2011
					RK
					HMR

1	2.5 µm MIN BRIGHT TIN/LEAD ENTIRE STOCK OVER 1.27 µm MIN NICKEL ENTIRE STOCK.
2	0.38 µm MIN GOLD IN LOCALIZED GOLD PLATE AREA, 2.5 µm MIN BRIGHT TIN/LEAD IN LOCALIZED TIN/LEAD PLATE AREA, BOTH OVER 1.27 µm MIN NICKEL ON ENTIRE STOCK.
3	0.76 µm MIN GOLD IN LOCALIZED GOLD PLATE AREA, 2.5 µm MIN BRIGHT TIN/LEAD IN LOCALIZED TIN/LEAD PLATE AREA, BOTH OVER 1.27 µm MIN NICKEL ON ENTIRE STOCK.
4	WIRE RANGE 26-30 AWG.
5	INSULATION RANGE 0.89-1.52
6	2.5 µm MIN BRIGHT TIN ENTIRE STOCK OVER 1.27 µm MIN NICKEL ENTIRE STOCK.
7	0.38 µm MIN GOLD IN LOCALIZED GOLD PLATE AREA, 2.5 µm MIN BRIGHT TIN IN LOCALIZED TIN PLATE AREA, BOTH OVER 1.27 µm MIN NICKEL ON ENTIRE STOCK.
8	0.76 µm MIN GOLD IN LOCALIZED GOLD PLATE AREA, 2.5 µm MIN BRIGHT TIN IN LOCALIZED TIN PLATE AREA, BOTH OVER 1.27 µm MIN NICKEL ON ENTIRE STOCK.
9	NOTE DELETED.
10	TIN PLATING THICKNESS INSIDE WIRE AND INSULATION BARRELS TO BE 1.27 µm MIN.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	29AUG2000
		CHK	W J RUDY
		CHK	W DAVIS
		APVD	W DAVIS
		APVD	29AUG2000
		PRODUCT SPEC	
		APPLICATION SPEC	
		WEIGHT	-
		CUSTOMER DRAWING	

DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	
mm			
		0 PLC	±
		1 PLC	±
		2 PLC	±0.13
		3 PLC	±
		4 PLC	±
		ANGLES	±
		FINISH	±

MATERIAL		0.20 THK BRASS	
----------	--	----------------	--

TE Connectivity		TE Connectivity	
NAME		PLUG CONTACT, CRIMP SNAP, 26-30 AWG, LOOSE PIECE, MICRO MATE-N-LOK(TM)	
SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A2	00779	C-794613	-
SCALE		SHEET	OF
10:1		1	1
		REV	B2

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9